



Intel Corporation
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054-1549

News Release

※本リリースは 2022 年 2 月 15 日に発表されたリリースを訳したものです

インテルがタワー セミコンダクターを 54 億ドルで買収

買収により、インテルのグローバルなエンドツーエンドのファンドリ事業が加速

ハイライト

- この買収は、世界的に多様なエンドツーエンドのファンドリとして、増大する半導体需要に対応し、およそ 1000 億ドルが対象となるファンドリ市場全体で、お客様により多くの価値をもたらします。
- 買収により、インテルは、ファンドリサービスとキャパシティの世界的な主要プロバイダーという位置づけを更に加速し、業界で最も幅広い差別化されたテクノロジーポートフォリオを提供します。
- 高度に補完されるこの買収では、インテルの最先端ノードと規模の製造をタワーセミコンダクターの専門技術とお客様第一のアプローチを組み合わせることで、最先端の技術と製造能力、強化された価値を世界中のお客様に提供します。
- この買収は、インテルの非 GAAP ベースの 1 株当たり利益を直ちに押し上げると見込まれます。
- インテルとタワーセミコンダクターの経営陣は、本日午前 5 時 30 分 PST(イスラエル時間午後 3 時 30 分)に投資家、メディアおよび業界アナリスト向けにカンファレンスコールを開催し、買収に関する詳細を説明する予定です。

カリフォルニア州、サンタクララおよびイスラエル ミグダハエメク 2022 年 2 月 15 日 - インテルコーポレーション (Nasdaq:INTC)とアナログ半導体ソリューションのリーディングファンドリであるタワーセミコンダクター (Nasdaq:TSEM)は、本日、インテルが現金で 1 株当たり 53 ドルでタワーを買収する最終合意に至ったことを発表しました。これは、企業価値として約 54 億ドルに相当します。この買収により、インテルの IDM 2.0 戦略が大幅に前進し、インテルは製造能力、グローバルフットプリント、テクノロジーポートフォリオをさらに拡大し、前例のない業界の需要に対応できるようになります。インテルの CEO、Pat Gelsinger 氏は次のように述べています。「タワーのスペシャルティテクノロジー、地理的条件、お客様との深い信頼関係、サービス・ファースト・オペレーションは、インテルのファンドリサービスの規模を拡大し、世界的なファンドリキャパシティの主要プロバイダーになるという目標を前進させる後押しとなります。今回の合意により、インテルは成熟したノードで

-- more --

魅力的な幅広い最先端ノードと差別化されたスペシャルティテクノロジーを提供できるようになり、半導体におけるこれまで前例のない需要の時代に、既存のそして将来のお客様に新たな機会を提供できるようになります」。

IDM 2.0 戦略の重要な部分として、インテルは 2021 年 3 月に [Intel Foundry Services \(IFS\)](#) を設立して、半導体製造能力に対する世界的な需要の高まりに対応し、米国およびヨーロッパを拠点とするファンドリキャパシティの主要プロバイダーとなり、世界中のお客様にサービスを提供できるようになりました。IFS は現在、最先端のプロセスおよびパッケージング技術、欧米をはじめとする将来の地域におけるコミットメント能力、幅広い知的財産(IP)ポートフォリオを提供しています。

高周波(RF)、パワー、シリコングルマニウム(SiGe)、産業用センサなどのスペシャルティテクノロジーにおけるタワーの専門知識、広範な IP および回路設計自動化技術(EDA)パートナーシップ、確立されたファンドリフットプリントは、インテルとタワー双方の世界中のお客様に幅広いサービスを提供します。タワーは、モバイル、自動車、パワーなどの高成長市場にサービスを提供しています。タワーは、ファブレス、IDM にサービスを提供し、米国、アジアにも拠点をもち、地理的優位性を活かしたファンドリ事業を展開しており、テキサス、イスラエル、イタリア、日本などで年間 200 万枚以上のウェハ生産能力を有しています。また、タワーは、設計サービスと能力だけでなく、業界をリードするカスタマーサポートポータルや IP ストアフロントと共に、ファンドリファーストのカスタマーサービスを提供します。

タワーの CEO、Russell Ellwanger は次のように述べています。「豊富な歴史を持つタワーは、お客様との深いパートナーシップを基盤に、世界的な製造能力に基づく驚異的な種類のアナログファンドリソリューションを構築してきました。私自身、当社の有能で熱意のある従業員をととても誇りに思います。インテルとともに、すべてのテクノロジーソリューションとノード、そして大幅に拡大したグローバルな製造拠点を通して、新しく有意義な成長の機会を推進し、お客様にさらに大きな価値を提供していきます。インテルのファンドリサービスにとって不可欠な部分となることに期待をしています。」

Intel Foundry Services のプレジデントである Dr.Randhir Thakur は次のように述べています。「タワーチームをインテルに迎え入れることができ、タワーの数十年に及ぶファンドリの経験、お客様との深い信頼関係、テクノロジーは、Intel Foundry Services の成長を加速させるでしょう。Intel Foundry Services は、最も幅広い IP、サービス、能力を備えたお客様第一のテクノロジーイノベーターとなるよう構築されています。タワーと IFS が一体となって、お客様の大望を実現するために、グローバル規模のファンドリソリューションを提供します。

インテルは、最近発表されたアリゾナ州とニューメキシコ州での生産能力拡大や、オハイオ州での新たなメガサイトの建設計画など、米国で研究開発と製造の両方を行っている唯一の最先端企業です。タワーの技術と製造拠点は、最先端プロセスにおけるインテルの IFS 能力を高く補完するものであり、統合後の会社がさらに規模を拡大し、お客様により広範な製品を提供できるようになります。タワーが加わることで、インテルは、対象となる 1,000 億ドル近いファンドリ市場全体で、お客様により多くの価値をもたらすことができるようになります。

買収内容と今後の予定

この買収でインテルの非 GAAP ベースの 1 株当たり利益を直ちに押し上げるとみられます。インテルは、この買収資金をバランスシートからの現金で賄う意向です。

買収手続きは約 12 か月で完了する見込みです。インテルとタワーの取締役会で満場一致で承認されており、タワーの株主の承認を含む通常の規制当局の承認および慣習的な完了条件が適用されます。

IFSとタワーセミコンダクターは買収完了まで独立して事業を稼働します。この間、IFSは引き続きThakur、タワーはEllwangerがトップとしてそれぞれ主導します。インテルは、買収完了後、両社が完全に統合されたファンドリ事業になることを目指しています。統合計画については、その時点で詳細を発表する予定です。

Goldman Sachs&Co.LLCはインテルの財務顧問を務め、Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LPとYigal Arnon&Co.は法律顧問を務めました。JPMorgan SecuritiesLLCはタワーのファイナンシャルアドバイザーを務め、Latham & Watkins, LLPとFISCHER (FBC & Co)が法律顧問を務めました。

買収に関するカンファレンスコール

インテルとタワーの経営陣は、本日午前5時30分PST(IST午後3時30分)に投資家、メディアおよび業界アナリスト向けにこの買収とインテルのファンドリ戦略についてカンファレンスコールを開催します。

<http://www.directeventreg.com/registration/event/4070988>にアクセスして、参加登録を行ってください。このカンファレンスコールは、米国内では1-888-869-1189、米国外では1-706-643-5902でアクセスできます。インテルのインベスターリレーションズのウェブサイト、INTC.comでリプレイが公開されます。

タワーセミコンダクター第4四半期および2021年度決算報告

タワーは、2022年2月17日に第4四半期と2021年度の財務報告を発行します。発表された取引に照らして、タワーは2022年第1四半期のガイダンスを提供せず、決算報告のカンファレンスコールは行いません。

インテルについて

インテルは業界のリーダーとして、世界中の進歩を促すとともに生活を豊かにする、世界を変えるテクノロジーを創出しています。ムーアの法則に着想を得て、顧客企業が抱える大きな課題を解決する半導体製品を設計・製造し、その進化に向けて日々取り組んでいます。クラウド、ネットワーク、エッジ、あらゆるコンピューティング機器のインテリジェント化によりデータの価値を最大化し、ビジネスと社会をより良く変革します。インテルのイノベーションについては、newsroom.intel.com または intel.com をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路(IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインインネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに2か所(150mmと200mm)、米国に2か所(200mm)、TPSCoが保有する日本の3か所(200mmと300mm)に生産拠点があり、イタリアに設立されている300mmファブをSTと共有しています。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。

Forward-Looking Statements

This document contains certain forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, related to the proposed transaction between Intel and Tower Semiconductor, including statements regarding the benefits and the timing of the transaction as well as statements regarding the companies’ products and markets. Words such as “anticipate,” “believe,” “could,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “likely,” “may,” “plan,” “potential,” “project,” “predict,” “seek,” “should,” “target,” “would” and “will” and variations of such words and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. Such statements are based on management’s expectations as of the date they were first made and involve risks and uncertainties that could cause our actual results to differ materially from those expressed or implied in our forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, among others, the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the companies’ businesses and the price of their securities; uncertainties as to the timing of the consummation of the transaction and the potential failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the receipt of certain governmental and regulatory approvals; the potential for regulatory authorities to require divestitures, behavioral remedies or other concessions in order to obtain their approval of the proposed transaction; the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the merger agreement; the effect of the announcement or pendency of the transaction on Intel’s business relationships, operating results, and business generally; delays, disruptions or increased costs in the integration of Tower Semiconductor’s technology into existing or new products; the potential that Tower Semiconductor shareholders may not approve the transaction; expected benefits, including financial benefits, of the transaction may not be realized; integration of the acquisition post-closing may not occur as anticipated, and the combined companies’ ability to achieve the growth prospects and synergies expected from the transaction, as well as delays, challenges and expenses associated with integrating the combined companies’ existing businesses may incur; litigation related to the transaction or otherwise; unanticipated restructuring costs may be incurred or undisclosed liabilities assumed; attempts to retain key personnel and customers may not succeed; risks related to diverting management’s attention from Intel’s ongoing business operations; exposure to inflation, currency rate and interest rate fluctuations and risks associated with doing business locally and internationally, as well as fluctuations in the market price of Intel and Tower Semiconductor’s traded securities; the impact of the COVID-19 pandemic on Intel and Tower Semiconductor’s business and general economic conditions; demands in Tower Semiconductor’s customer end markets and for Tower Semiconductor’s foundry services and/or products that exceed Tower Semiconductor’s capacity; ongoing or potential litigations or disputes, incidental to the conduct of Tower Semiconductor’s ongoing business, with customers, suppliers, landlords, or other third parties; the business combination or the combined company’s products may not be supported by third parties; actions by competitors may negatively impact results; potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the transaction; potential negative changes in general economic conditions in the regions or the industries in which Intel and Tower Semiconductor operate; potential failure to meet the conditions set in the approval certificates received from the Israeli Investment Center under which Tower Semiconductor received a significant amount of grants in past years; exposure to inflation, currency rates (mainly the Israeli Shekel and Japanese Yen); and other risks detailed in Intel’s and Tower Semiconductor’s filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) including those discussed in Intel’s most recent Annual Report on Form 10-K and in any subsequent periodic reports on Form 10-Q and Form 8-K and Tower Semiconductor’s most recent Annual Report on Form 20-F and in any subsequent reports on Form 6-K, each of which is on file with or furnished to the SEC and available at the SEC’s website at www.sec.gov. SEC filings for Intel are also available on Intel’s Investor Relations website at www.intc.com, and SEC filings for Tower Semiconductor are available in the Investor Relations section of Tower Semiconductor’s website at ir.towersemi.com. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates. Unless otherwise required by applicable law, Intel and Tower Semiconductor undertake no obligation and do not intend to update these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Additional Information and Where to Find It

This communication is being made in respect of the proposed transaction. Tower Semiconductor intends to furnish to the SEC and mail or otherwise provide to its shareholders a proxy statement in connection with the proposed transaction with Intel (the “proxy statement”), and each party will file or furnish other documents regarding the proposed transaction with the SEC. The proxy statement will be sent or given to the shareholders of Tower Semiconductor and will contain important information about the proposed transaction and related matters. This communication is not a substitute for the proxy statement or any other document that may be filed or furnished by Tower Semiconductor with the SEC. Investors and security holders are urged to read the proxy statement in its entirety and other relevant documents filed with or furnished to

Intel/Page 5

the SEC in connection with the proposed transaction or incorporated by reference therein when they become available before making any voting or investment decision with respect to the proposed transaction because they will contain important information about the proposed transaction and the parties to the proposed transaction.

You may obtain copies of all documents filed with or furnished to the SEC regarding this transaction, free of charge, at the SEC's website (www.sec.gov). In addition, investors and shareholders will be able to obtain free copies of the proxy statement and other documents filed with or furnished to the SEC by Intel on Intel's Investor Relations website (www.intc.com) or by writing to Intel, Investor Relations, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 (for documents filed with the SEC by Intel), or by Tower Semiconductor on Tower Semiconductor's Investor Relations website (ir.towersemi.com) or by writing to Tower Semiconductor, Corporate Secretary, 20 Shaul Amor Street, Ramat Gavriel Industrial Park, P.O. Box 619, Migdal Haemek 2310502, Israel (for documents filed with or furnished to the SEC by Tower Semiconductor).

© Intel Corporation. Intel, the Intel logo and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. Other names and brands may be claimed as the property of others.

Intel/Page 6

CONTACTS: Penelope Bruce Kenji Morita
Intel Media Relations Intel Investor Relations
1-408-893-0601 1-408-765-7700
Penelope.Bruce@intel.com Kenji.Morita@intel.com

Noit Levy
Tower Semiconductor Investor Relations and Corporate Communications
+972-4-604-7066
noitle@towersemi.com